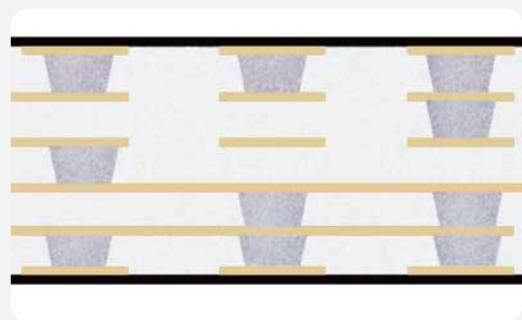


# メタライズペースト

半導体用途等、高い接続信頼性が求められる基板に

## 用途

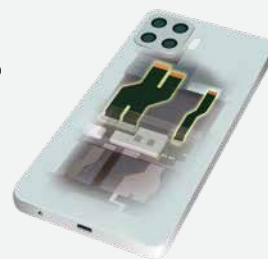
### 層間接続用途



高速通信基板での層間接続イメージ

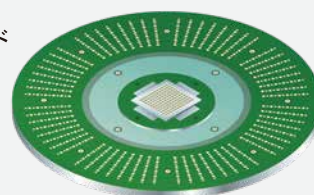
#### 民生品

イメージ：スマートフォン等の  
高速通信基板



#### 半導体検査基板

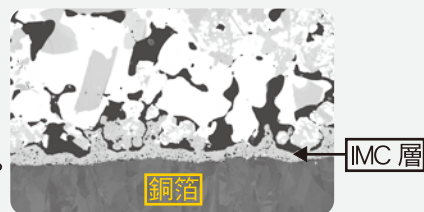
イメージ：プローブカード



## 特徴

### メタライズペーストとは

高融点、低融点の金属粉をブレンドした金属溶融型ペースト。  
加熱プレスすることにより、高融点と低融点金属が IMC 層を形成。  
銅箔とも IMC 層を形成し、高い接続信頼性を生み出します。



- 銅箔と IMC 層を形成。各種基材で安定した接続信頼性を実現。
- 高耐熱・高熱伝導性
- スルーホールめっき不要の為、ファインパターンの形成が容易

## ラインナップ & 特性

製品型番			MP8300	MPA500	MPA510	MPA550
粘度	BH型	dPa・s	1,400 ~ 2,200	1,000 ~ 2,000	900 ~ 1,700	1,200 ~ 2,000
硬化条件	本硬化		180°C × 60分			
体積抵抗率[代表値]		Ω・cm	8.00E-05	1.50E-04	2.00E-04	8.00E-05
熱伝導性 (レーザーフラッシュ法)		W/m・k	25	12		20
ガラス転移温度 (DMA)		°C	151	147		

